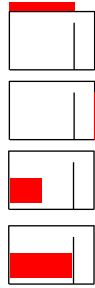


# SMT

## Werbebanner auf [www.SMT-Verlag.de](http://www.SMT-Verlag.de)

### emv-esd

### CADS



Typ	Größe in Pixel	Formate	Preise pro Woche
Super Banner	728 x 90	GIF/JPG/Flash	300 €
Wide Skyscraper	160 x 600	GIF/JPG/Flash	250 €
Rectangle	180 x 150	GIF/JPG/Flash	150 €
Medium Rectangle	300 x 250	GIF/JPG/Flash	250 €

Sie können selbstverständlich auch jedes andere Format wählen, inklusive Video. Bitte fragen sie bei uns an!

#### Redaktion

Dipl.-Ing. Jost Dennier  
info@smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1  
55218 Ingelheim  
Tel: 06132 4316-47  
Fax: 06132 4316-49

#### Vertrieb

info@smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1  
55218 Ingelheim  
Tel: 06132 4316-47  
Fax: 06132 4316-49

#### Anzeigenverkauf

Tel: 06132 4316-47  
Fax: 06132 4316-49  
E-mail: info@smt-verlag.de

# MEDIADATEN 2016

THEMEN  
TERMINE  
PREISE

Fachzeitschrift für Advanced Packaging & Elektronikfertigung

# SMT

## emv-esd

FACHZEITSCHRIFT FÜR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT & AUSWIRKUNG ELEKTROSTATISCHER AUFLADUNG

### CADS

CAE/CAD/CAM/CAQ

SMT | FACHZEITSCHRIFT FÜR ADVANCED PACKAGING & ELEKTRONIKFERTIGUNG

JAHRGANG 28  
OKTOBER 2015  
WWW.SMT-VERLAG.DE

30974

10 **SMT** + CADs 3

**BECKER & MÜLLER SCHALTUNGSDRUCK GMBH –**  
**30 JAHRE MUSTER- UND KLEINSERIENFERTIGUNG VON LEITERPLATTEN**

3D-Inline-Röntgen (AXI) mit neuen Maßstäben      Marktübersicht Bestückssysteme      FPGA-basiertes Design mit Gigasample-Wandlern bringt den DDC auf das Board

- Herausgeber:** Jost Dennier
  
- Redaktion:** Jost Dennier  
**Anschrift:** Redaktion SMT/CADS/EMV-ESD  
 Oberer Schenkgarten 1  
 55218 Ingelheim  
 Tel.: (0 61 32) 43 16 47  
 Fax: (0 61 32) 43 16 49  
 E-Mail: info@smt-verlag.de
  
- Anzeigen:** Telefon: (0 613 2) 43 16 47,  
**Anschrift:** Fax: (0 61 32) 43 16 49  
 E-Mail: info@smt-verlag.de
  
- Inhaber:** Jost Dennier
  
- Verlag:** SMT-VERLAG  
 Oberer Schenkgarten 1  
 55218 Ingelheim
  
- Jahrgang:** 29. Jahrgang 2016
  
- Erscheinungsweise:** 8 x jährlich
  
- Erscheinungs-/Redaktionsplan:** siehe Seite 5/6
  
- Bezugspreise:**

Jahresabonnement:	58,00 Euro inkl. Versand
Einzelheft:	9,00 Euro
Jahresabo: EMV-ESD bzw. CADS	29,00 Euro inkl. Versand

#### ■ Kurzcharakteristiken:

»SMT Germany« ist die Fachzeitschrift für alle Bereiche der Elektronik-Fertigung und des Advanced Packaging.

#### Schwerpunkte sind:

Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung, Halbleiterfertigung sowie Test und Qualitätssicherung. Ergänzt werden diese Themen durch Marktübersichten zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen für die Elektronik-Fertigung.

»CADS« als Supplement von SMT Germany informiert über die Bereiche Entwicklung und Konstruktion in der Elektronik. Redaktioneller Schwerpunkt ist die Design-Automation bei der Anwendung von CA-Techniken inklusive CAE/CAD/CAM/CAT/CAQ.

»EMV-ESD« ist das kompetente Fachforum für alle Fragen der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Auswirkung elektrostatischer Aufladung sowie der messtechnischen Erfassung dieser Erscheinungen.

**Zielgruppen** sind Fachleute in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Qualitätssicherung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie sowie in anderen Industriebereichen, die Elektronik in ihren Erzeugnissen einsetzen.

#### ■ Auflagen-Analyse: Intern (30.09.2014 -01.10.2015)

■ **Druckauflage:** 9500

#### ■ Tatsächlich verbreitete Auflage

im Jahresdurchschnitt: 9308

■ **Verkaufte Auflage:** 838

■ **Freistücke:** 8212 pro Ausgabe

■ **Rest-, Archiv- und Belegexemplare:** 258 pro Ausgabe

#### ■ Geographische Verbreitungsanalyse

Wirtschaftsraum	Anteil an der Auflage in %	
<b>Inland</b>		
Postleitzahl 0	221	2,4
Postleitzahl 1	331	3,6
Postleitzahl 2	507	5,4
Postleitzahl 3	715	7,7
Postleitzahl 4	621	6,7
Postleitzahl 5	752	8,1
Postleitzahl 6	1131	12,2
Postleitzahl 7	1992	21,4
Postleitzahl 8	1607	17,3
Postleitzahl 9	823	8,8
<b>Ausland</b>		
Schweiz	181	1,9
Österreich	112	1,2
Großbritannien	83	0,9
Niederlande	81	0,9
Sonstiges Ausland	151	1,6
<b>Gesamtauflage</b>	<b>9308</b>	<b>100,0</b>

## Branchen-/Wirtschaftszweige

Nr. Grundsystematik	Empfängergruppen	Exemplare	%
242	Maschinenbau	639	6,9
243	Datenverarbeitung/ Büromaschinen	159	1,7
244	Fahrzeugbau	247	2,7
248	Luft- und Raumfahrt	288	3,1
250	<b>Elektronikfertigung</b>	3751	40,3
	Unterhaltungselektronik	172	1,8
	Medizin techn. / Optik	316	3,4
	Leiterplattenhersteller	243	2,6
	Ing. Büros/Dienstleistung	1251	13,4
	Mess- und Regeltechnik	417	4,5
5	Nachrichtentechnik / Verkehr	836	9,0
	Bauelemente-Hersteller	241	2,6
	Stromerzeugung	58	0,6
9	Ausbildung / Forschung	622	6,7
	Sonstige Branchen	68	0,7
Tatsächlich verbreitete Auflage		9308	100,0

## Betriebsgröße

	Exemplare	%
1 bis 9 Beschäftigte	1491	16,0
10 bis 49 Beschäftigte	1153	12,4
50 bis 99 Beschäftigte	781	8,4
100 bis 499 Beschäftigte	2286	24,6
500 bis 999 Beschäftigte	838	9,0
1000 und mehr Beschäftigte	2759	29,6
	9308	100

## Betriebliche Funktion

	Exemplare	%
Unternehmensleitung	610	6,6
Techn. Management	2181	23,4
Forschung/Entwicklung	2512	27,0
Konstruktion	718	7,7
Fertigung	1981	21,3
Qualitätskontrolle, Test	535	5,7
Verkauf	304	3,3
Marketing / Werbung	400	4,3
Studenten	42	0,5
Hochschulen/Sonstige	25	0,3
	9308	100,0

**Zeitschriftenformat:** DIN A4 210 breit x 297 hoch mm  
Anschnitt 216 breit x 303 hoch mm

**Satzspiegel:** 185 breit x 260 hoch mm

**Anzeigenformate und Grundpreise: Preise in Euro**

Format	Breite x Höhe Preise s/w	Maße angeschnitten	bei Anzeigen pro Jahr				
			1x	2x	4x	6x	8x
1/1- Seite	185 x 260	216 x 303	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.700,00
3/4- Seite	140 x 260 oder 185 x 195	146 x 303	2.900,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00
2/3- Seite	123 x 260 oder 185 x 173	129 x 303	2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
1/2 Juniorpage	135 x 195	138 x 198	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
1/2- Seite	93 x 260 oder 185 x 130	96 x 303 oder 216 x 133	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
1/3- Seite	62 x 260 oder 185 x 87	65 x 303 oder 216 x 90	1.450,00	1.250,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00
1/4- Seite	46 x 260 oder 185 x 62 oder 93 x 130	96 x 133 oder 216 x 65 oder 49 x 303	1.030,00	980,00	920,00	880,00	820,00
1/8- Seite	46 x 130 oder 93 x 62 oder 185 x 33	49 x 133 oder 96 x 65 oder 216 x 36	530,00	504,00	474,00	440,00	430,00
1/16- Seite	46 x 62 oder 93 x 31		360,00	340,00	324,00	303,00	285,00

**Preise für Vorzugsplätze:** 2., 3. und 4. Umschlagseite +15%  
**Sonstige Platzierungsvorschrift:** +10% auf den Grundpreis  
Anschnittzuschläge werden **nicht** berechnet

## Farbzuschläge:

Format	2-farbig (Skala)	3-farbig	4-farbig	Sonderfarbe
1/1 oder kleiner	390,00	750,00	950,00	600,00
1/2 oder kleiner	300,00	580,00	750,00	600,00
1/4 oder kleiner	250,00	450,00	550,00	600,00

## Gelegenheitsanzeigen und Stellenangebote

Je mm bei einer Spaltenbreite von 42 mm € 3,00

## Bankverbindung:

Jost Dennier Mainzer Volksbank Kto.-Nr.: 787 587 013 BLZ: 551 900 00  
BIC-Code: MVBMD55 IBAN: DE8355190000787587013

**Zahlungsbedingungen:** Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit  
2% Skonto oder 20 Tage ohne Abzug.

## Einhefter/Einkleber:

Papiergewicht: 80 bis 120 g/m<sup>2</sup>

2 Seiten (nur Einkleber)	4 Seiten	6 Seiten	8 Seiten
3 450,00	4 990,00	6 610,00	8 240,00

## Beilagen: Teilbeilagen sind möglich

bis 25 g/1000 inkl. Porto bis 50 g/1000 inkl. Port  
270,00 370,00

## Druckverfahren: Offset

**Druckunterlagen:** PDF- und eps-Dateien als Druckunterlagen werden  
bevorzugt.

**Versandanschrift:** SMT-Verlag, Oberer Schenkgarten 1,  
55218 Ingelheim, Tel: 06132 431647, Fax: 06132 431649,  
E-Mail: info@smt-verlag.de

Aufträge gemäß den Standard-Geschäftsbedingungen für Anzeigen und  
Fremdbeilagen in Fachzeitschriften.

Termine	Schwerpunktthemen SMT	Schwerpunkte CADS	Schwerpunkte EMV-ESD	Messen
<b>Ständige Schwerpunkte</b>	<b>Advanced Packaging Baugruppenfertigung Leiterplattenfertigung Test- und Qualitätssicherung Marktübersichten</b>	<b>EDA, Leiterplatten- und Baugruppendesign, Entwurfswerkzeuge, Logikanalyse, Logiksynthese, Simulation</b>	<b>Normung, Messen/Prüfen, Schirmung, Filter, Antennen, Überspannungsschutz, Elektrostatische Entladungen</b>	
<b>Januar/ Februar mit EMV-ESD 1</b>  <b>Messeheft EMV 2016</b> Redaktionsschluss 05.02.2016 Anzeigenschluss 10.02.2016 Erscheinungstermin <b>16.02.2016</b>	Reparatur/Rework, Löttechnik, Bestücktechnik, Photovoltaik Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer, Reinraumtechnik Baugruppentest, Halbleitertest, AOI  <b>Marktübersicht: Steckverbinder</b>		<b>Vorschau EMV 2016</b> Störfestigkeit Messtechnik Antennen Stromversorgung Produktsicherheit	<b>APEX</b> 15.03 - 17.03.2016 Las Vegas  <b>EMV 2016</b> 23.02. - 25.02.2016 Düsseldorf
<b>März mit CADS 1</b> Redaktionsschluss 09.03.2016 Anzeigenschluss 16.03.2016 Erscheinungstermin <b>23.03.2016</b>	Vorberichte » <b>SMT Hybrid Packaging</b> «  Bestücktechnik, Photovoltaik- Produktion Leiterplatten, Microvias, HDI Packaging, Bonding AOI, AXI, Flying Prober  <b>Marktübersicht: Lohnfertiger</b>	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		<b>CeBIT</b> 14.03. - 18.03.2016 Hannover  <b>Hannover Messe</b> 23.04. - 29.04.2016 Hannover
<b>April/Mai mit EMV-ESD 2</b>  <b>Messeheft SMT/ Hybrid/ Packaging</b> Redaktionsschluss 06.04.2016 Anzeigenschluss 13.04.2016 Erscheinungstermin <b>20.04.2016</b>	Vorberichte » <b>SMT Hybrid Packaging</b> «  Packaging, Lötverfahren, Bestückung Sieb-/Schablonendruck AOI, AXI  <b>Marktübersicht: Lötssysteme</b>		<b>EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 1</b> Nachbericht EMV 2016 Messtechnik Filter, Stromversorgung Gehäuse ESD, Produktsicherheit	<b>SMT/Hybrid/ Packaging 2016</b> 26.04. - 28.04.2016 Nürnberg
<b>Juni/ Juli mit CADS 2</b> Redaktionsschluss 15.06.2016 Anzeigenschluss 22.06.2016 Erscheinungstermin <b>29.06.2016</b>	Nachberichte » <b>SMT Hybrid Packaging</b> «  Löttechnik, Selektivlöten Dispensen, Bestückung MCM, Photovoltaik-Produktion Board-Test, ICT, AOI, AXI  <b>Marktübersicht: Schablonendruck</b>	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		<b>parts2clean 2016</b> 31.05. - 02.06.2016 Stuttgart
<b>August/ September mit EMV-ESD 3</b> Redaktionsschluss 17.08.2016 Anzeigenschluss 24.08.2016 Erscheinungstermin <b>31.08.2016</b>	Packaging, Chip-on-Board, Rework, Bestücktechnik, Schablonendruck Testsysteme, Lötssysteme  <b>Marktübersicht: Baugruppentester</b>		<b>EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 2</b> Laboreinrichtungen ESD, Überspannung Störfestigkeit Antennen, Messtechnik	<b>Intersolar Europe</b> 22.06. - 24.06.2016 München
<b>Oktober mit CADS 3</b> Redaktionsschluss 14.09.2016 Anzeigenschluss 21.09.2016 Erscheinungstermin <b>28.09.2016</b>	Vorberichte » <b>electronica</b> «  Bestückung, Dosiereinrichtungen Löten, AOI, AXI, Flying Prober, Packaging, Chip-on-Board, Rework  <b>Marktübersicht: Bestückssysteme</b>	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		<b>Motek 2016</b> 10.10. - 13.10. 2016 Stuttgart  <b>Semicon Europe</b> 25.10. - 27.10.2016 Grenoble
<b>November mit EMV-ESD 4</b> <b>MESSEHEFT »electronica 2015«</b> Redaktionsschluss 19.10.2016 Anzeigenschluss 26.10.2016 Erscheinungstermin <b>02.11.2016</b>	Vorberichte » <b>electronica</b> « Boardhandling, Bonding Löttechnik, Bestücktechnik Packaging, Underfill, Bonding Testautomation, Boundary Scan <b>Marktübersicht: Leiterplattenhersteller</b>		Messtechnik Antistatische Materialien Dienstleistungen Störfestigkeit Produktsicherheit	<b>electronica 2016</b> 08.11. - 11.11.2016 München  <b>SPS/IPC/DRIVES</b> 22.11 - 24.11.2016 Nürnberg
<b>Dezember mit CADS 4</b> Redaktionsschluss 30.11.2016 Anzeigenschluss 07.12.2016 Erscheinungstermin <b>14.12.2016</b>	Nachberichte » <b>electronica</b> « Packaging, Bestückung, Leiterplattenfertigung, Schablonendruck, Photovoltaik Löttechnik, Lotpasten, neue Trends <b>Marktübersicht: Bondsysteme</b>	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		